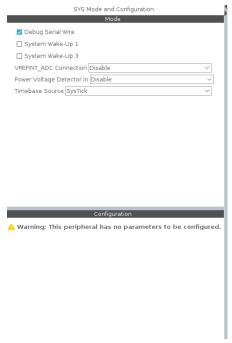
1. Saisie du schéma

1.1 Création de la structure du projet

Dans SYS, activez Debug Serial Wire.



 VDD
 PA14.
 SYS_SWQLK

 PC14...
 PA15...
 PA11
 PA10...

 PA0-...
 PA1
 PA9
 PA9

 PA1
 PA9
 PA9
 PA9

 PA1
 PA9
 PA9
 PA9

 PA1
 PA9
 PA9
 PA9

 PA1
 PA9
 PA9
 PA9

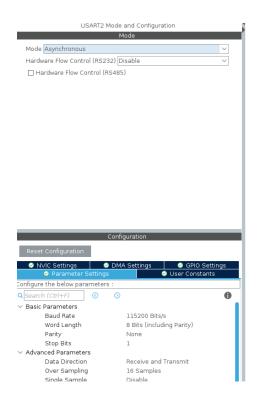
 PA1
 PA1
 PA1
 PA1

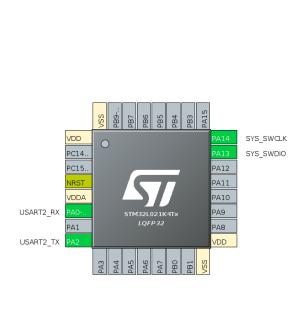
 PA2
 PA1
 PA1
 PA1

 PA2
 PA1
 PA1
 PA2

Pinout view System view

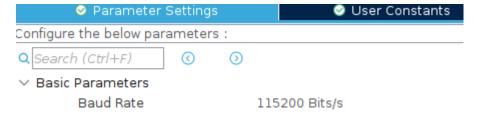
Activez l'USART2 en mode Asynchrone.



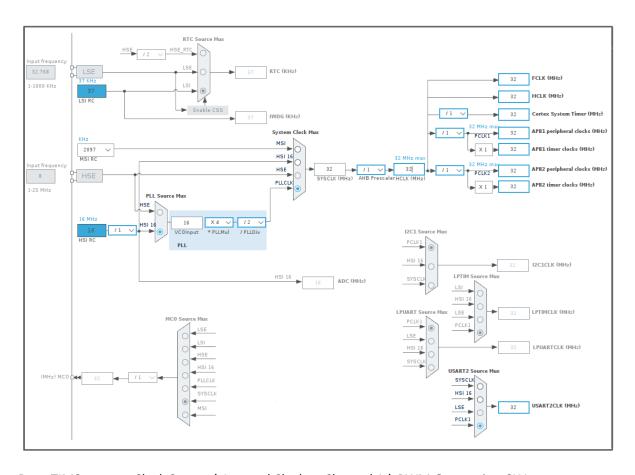


Pinout view System view

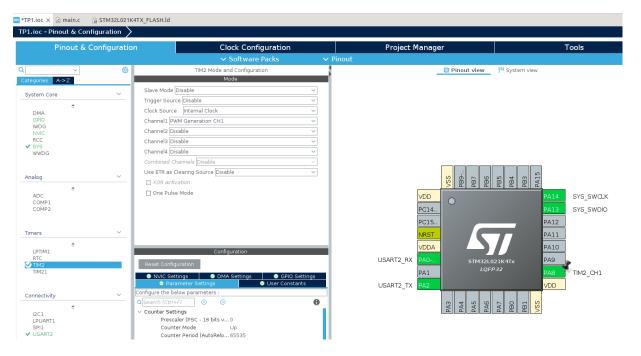
le baud rate



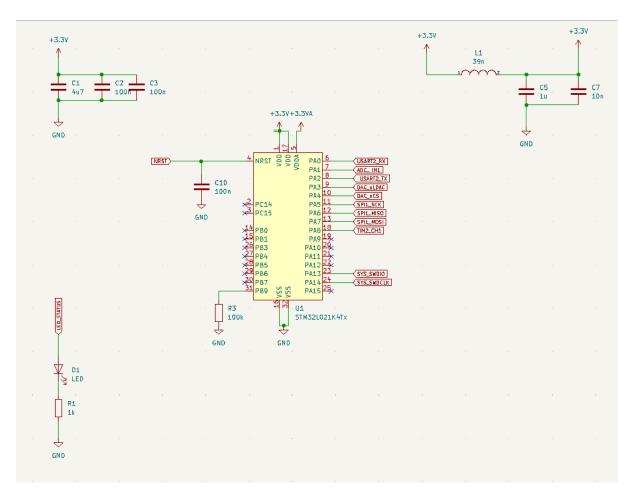
Dans l'onglet Clock Configuration, configurez l'horloge système à sa valeur maximale: 32 MHZ



Dans TIM2, mettez Clock Source à Internal Clock et Channel 1 à PWM Generation CH1.



1.2 Le microcontrôleur sous KiCAD



Pourquoi PB9 est relié à la masse?

Réponse:

PB9 n'est pas relié directement à la masse. Elle est reliée à la masse à travers une résistance pull down. Elle fonctionne comme une résistance de tirage (vers le bas). Son rôle est de s'assurer que la broche reste à un niveau logique bas (OV) lorsque rien n'est connecté à celle-ci ou si le dispositif connecté est en haute impédance. Cela évite que la broche flotte, ce qui pourrait mener à des états logiques indéfinis et à une consommation de courant inutile due aux oscillations de la tension.

De plus si PB9 est utilisée comme entrée, la résistance permet à la broche de détecter un niveau bas jusqu'à ce qu'elle soit intentionnellement mise à un niveau haut par un autre circuit.

La valeur élevée de la résistance (100k ohms) assure qu'il y a une très faible consommation de courant à travers la résistance lorsque la broche est mise à un niveau haut par le microcontrôleur ou un autre circuit. Cette configuration permet donc d'économiser de l'énergie et de prévenir un état indéfini sans interférer avec les signaux actifs.

Quel est le rôle de L1, C5 et C7?

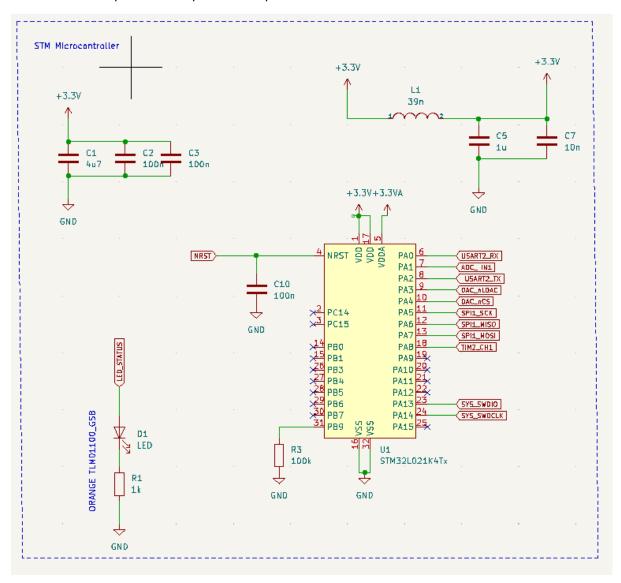
Réponse:

C5 et C7 sont des condensateurs de découplage et L1 joue le rôle de filtre

L1 forme une barrière contre le bruit de haute fréquence tandis que C7 aide à court-circuiter ce bruit vers la masse, l'éliminant ainsi du système. C5 agit comme un réservoir d'énergie pour gérer les

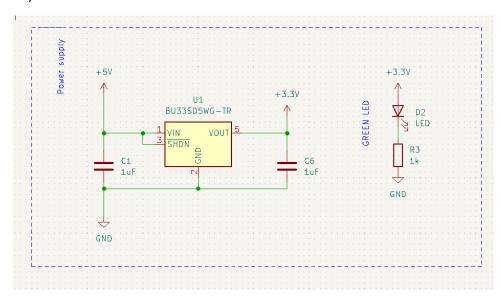
besoins en courant plus lent et plus large de la puce. Cette combinaison permet de filtrer une large gamme de fréquences de bruit et assurer une alimentation propre et stable pour le microcontrôleur.

Le schéma correspondant à la partie microprocesseur :



1.3 Le reste du schéma

Le schéma correspondant de la partie Power supply (utilisé le régulateur linéaire LDO BU33SD5WG-TR) :



Quelle page de la datasheet indique les valeurs des condensateurs ?

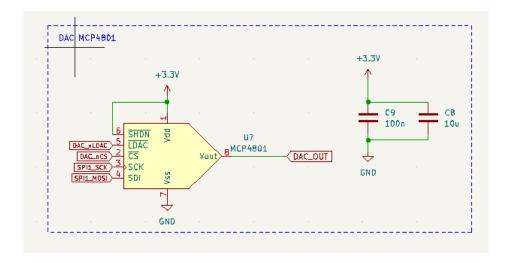
Réponse : Page 3 du datasheet "buxxsd5wg-e".

● Recommended Operating Conditions

| Parameter | Symbol | Limit | | | Unit | Conditions |
|------------------|--------|----------|-----|-----|-------|-------------------------------------|
| raiailletei | Symbol | Min | Тур | Max | Offic | Conditions |
| Input capacitor | Cin | 0.47(*2) | 1.0 | _ | μF | A ceramic capacitor is recommended. |
| Output capacitor | Cout | 0.47(*2) | 1.0 | - | μF | A ceramic capacitor is recommended. |

^(*2) Set the value of the capacitor so that it does not fall below the minimum value. Take into consideration the temperature characteristics, DC bias characteristics, and degradation with time.

Le schéma du DAC :



Quelle page de la datasheet nous indique les valeurs de condensateurs ?

Réponse: Page 15 du datasheet "22244B-54643"

Using an appropriate bypass capacitor of about 0.1 μ F (ceramic) to ground is recommended. An additional 10 μ F capacitor (tantalum) in parallel is also recommended to further attenuate high-frequency noise present in application boards.

Quel est le rôle de la broche CS?

<u>Réponse</u>: La broche CS est utilisée pour activer et désactiver le dispositif DAC. Lorsque la broche CS est mise à bas (niveau logique 0), le DAC est sélectionné et peut communiquer avec le microcontrôleur. Lorsque CS est à haut (niveau logique 1), le DAC ignore les signaux du bus SPI, permettant ainsi à d'autres dispositifs sur le même bus SPI de communiquer sans interférence.

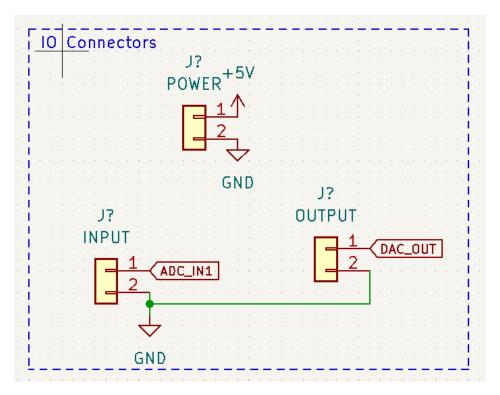
Quel est le rôle de la broche LDAC?

<u>Réponse</u>: La broche LDAC est utilisée pour contrôler le moment où la sortie du DAC est mise à jour. Dans certains DACs, il est possible d'écrire dans un premier temps la donnée numérique dans un registre interne, puis, en mettant la broche LDAC à bas, d'indiquer au DAC de mettre à jour la sortie analogique avec la valeur stockée dans ce registre.

Pourquoi le signal MISO n'est pas utilisé?

<u>Réponse</u>: Le signal MISO n'est pas utilisé dans ce cas car le MCP4801 est un DAC unidirectionnel qui ne nécessite que des données entrantes du microcontrôleur pour définir le niveau de tension de sortie. Il n'y a pas de nécessité pour le DAC d'envoyer des données en retour au microcontrôleur, d'où l'absence de connexion MISO dans ce cas. Le bus SPI est donc utilisé en mode unidirectionnel ici, seulement pour envoyer des données au DAC.

Les schémas des connecteurs :



Où trouve-t-on les indications du pinout du connecteur SWD?

<u>Réponse</u>: Les indications sont trouvables sur le lien suivant :

https://stm32-base.org/guides/connecting-your-debugger.html

Connecting via SWD header

The easiest way to connect your development board to your debugger is by using the 4-pin SWD header, if present. This header is usually a male dupont header, but female headers are also used. The header exposes a ground pin, a +3.3V pin, a clock pin, and a data pin.

Note: There is no particular order in which these pins are arranged.

Warning: Do not connect the +3.3V pin if you are powering your board externally, as most Chinese development boards do not have any protection on the power pins. This may cause damage your board, debugger or PC.

The table below provides an overview of which pins to connect:

| Pin function | Debugger pin | Target pin |
|--------------|------------------|--------------|
| Ground pin | GND | GND |
| +3.3V pin | VCC / VDD / 3.3V | VCC/VDD/3.3V |
| Clock pin | SWCLK / SWCK | CLK/SWCLK |
| Data pin | SWDIO | DIO/SWDIO |

1.4 Affectation des empreintes

Que signifie 0805 ? 0603 ? 1206 ?

<u>Réponse</u>: Les chiffres 0805, 0603 et 1206 font référence à des tailles standard de composants électroniques en montage en surface (SMD, pour Surface-Mount Device). Ces chiffres indiquent les dimensions du composant : 0603 désigne un composant qui mesure environ 0.06 pouces x 0.03 pouces, soit 1.6 mm x 0.8 mm.

0805 désigne un composant qui mesure environ 0.08 pouces x 0.05 pouces, soit 2.0 mm x 1.25 mm.

1206 désigne un composant qui mesure environ 0.12 pouces x 0.06 pouces, soit 3.0 mm x 1.5 mm.

Que signifie LQFP ? SOT-223 ? SOIC ? Ne vous contentez pas de donner le sigle, j'attends une petite description (vous pouvez copier-coller depuis wikipedia, mais lisez avant quand même))

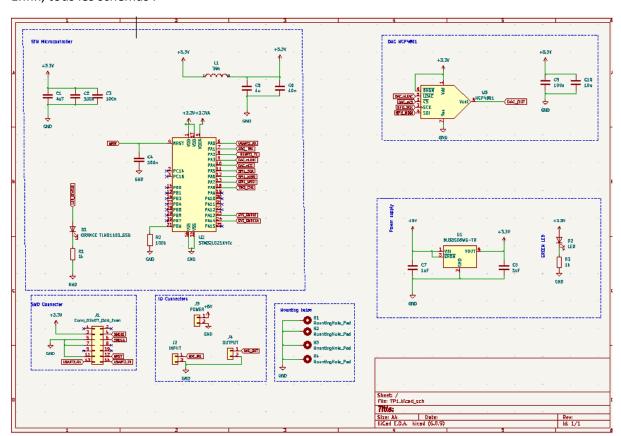
Réponse:

LQFP (Low-profile Quad Flat Package): Il s'agit d'un type de boîtier plat rectangulaire avec des connexions sur les quatre côtés. Il est conçu pour occuper peu d'espace en hauteur (d'où le terme "low-profile") et offre une bonne efficacité pour la dissipation thermique. Les broches sortent des côtés du composant et se replient sous le boîtier, ce qui permet un montage en surface sur un circuit imprimé.

SOT-223 (Small Outline Transistor-223): C'est un type de boîtier pour les composants à semiconducteurs qui est plus grand que le traditionnel SOT-23, offrant une meilleure capacité de dissipation de chaleur. Le boîtier SOT-223 a généralement trois broches et une grande languette métallique à l'arrière qui sert à la fois de broche électrique supplémentaire et de dissipateur thermique.

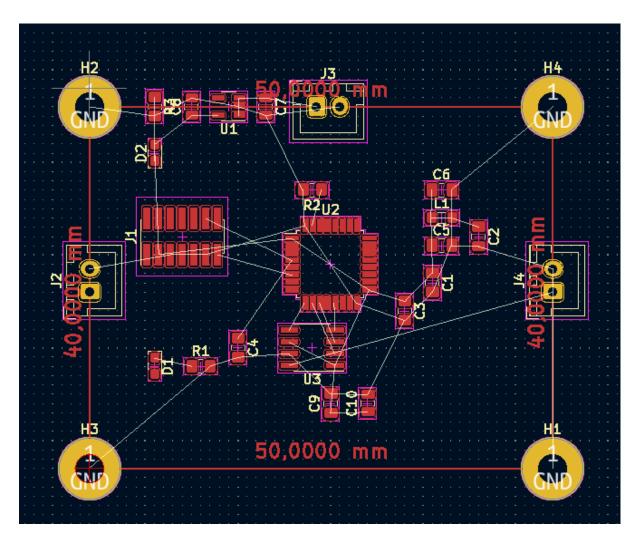
SOIC (Small Outline Integrated Circuit): C'est un type de boîtier à montage en surface utilisé pour les circuits intégrés. Il a des broches sur les deux côtés et est plus étroit que le boîtier DIP (Dual Inline Package) traditionnel.

Enfin, tous les schémas :



2 Routage du circuit

2.1 Placement des composants



2.2 Routage

